PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

53-093390

(43)Date of publication of application: 16.08.1978

(51)Int.CI.

H01B 9/02

(21) Application number: 52-007596

(71)Applicant:

HITACHI CABLE LTD

(22)Date of filing:

26.01.1977

(72)Inventor:

KAWADA SHICHIRO

SHIMAZAKI YUKIO TAKAHATA NORIO

(54) **POWER CABLE**

(57) Abstract:

PURPOSE: To provide a good property for both exfoliation from and adhesiveness to the insulation layer, by constructing the external semi-conductive layer with a mixed substance of specific proportion of three components, graft copolymer, butadiene acrylonitrile copolymer and ethylene copolymer.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's

decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

(9日本国特許庁

公開特許公報

⑩特許出願公開

昭53—93390

MInt. Cl.2 H 01 B 9/02 識別記号

砂日本分類 60 B 4 60 C 11

广内整理番号 7337--52 7037-52

砂公開 昭和53年(1978)8月16日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 8 頁)

60電力ケーブル

願 昭52-7596

创特

昭52(1977)1月26日 **②出**

@発 明 川和田七郎

日立市日高町5丁目1番地

立電線株式会社研究所内

同 島崎行雄

日立市日高町5丁目1番地 日

立電線株式会社研究所内

70発 明 者 高畑紀雄

日立市日高町5丁目1番地 日

立電線株式会社研究所内

願 人 日立電線株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目1

番2号

個代 理 人 弁理士 佐藤不二雄

発明の名称 自力ケーブル

特許請求の範囲

導体上に形成されたオレスイン重合体(ポリオ レフイン食合体も含む)より成る絶縁体の 周上に 外部半導電層が形成されており、との外部半導電 層は。(1) 塩素化ポリエチレンに塩化ビニルをグ ラフト共自合させて成るグラフト共重合体 (2)ブ タシエンーアクリロニトリル共富合体および(3)エ チレン共置合体をこれらの3成分の混合比に関す る三角座標(第1節)において点A(5056,20 %, 30%), B(30%, 20%, 50%), H (20%, 30%, 50%), C (20%, 50%, 30%), D(30%, 50%, 20%) E(50%,30%,20%),を各頂点とした 六角形の枠内に入るような割合にて混合せしめた。 混合物と。導電性カーボンブラックとの混和物に より構成されていることを特色とする電力ケーブ

発明の詳細な説明

本発明は絶縁体と外部半導電層とが良好に密剤 していると共に必要に応じて外部半導電層を極め て容易にはく誰することのできる事力ケーブルに 関するものである。

高圧用の電力ケーブルは、外部電界の集中を設 和するために、絶象体の外間に外部半導電腦が形 成されている。

すなわち、添付図面第2図に示すように、導体 1上に内部半導電層 2、ポリエチレン等の絶縁体 3,外部半導電層4が順次形成された構造にある。 とのようた言力ケーブルを接続する場合。外部半 導電腦4を,絶縁休3にきずをつけることなく。 剱離させることが要求される。

すなわち。外部半導電層と絶縁体との過度の袋 着は、絶象体からの外部半導電層のはく離を著し く困難なものとし、端末処理作業に多くの時間や 労力あるいは熟練性を必要とするようになる。 然るに従来との種半導電層と して最良されている エチレンービニルエステル共重合体をペースレジ ンとした半導電層は、それがこの半導電層が多用

されている一所次ではあるけれども。絶縁体を構 成するオレフイン重合体と極めて強力に接着する 性質を有していることから。絶縁体からのはく離 が不可能となり。ためにケーブル幅末処理作業を 若しく困難なものにしていた。

本発明は絶縁体と外部半導電層とが良好に密着 していると共に必要に応じて極めて容易に外部半 導竜層をはく離することができ。 しかも外 部半導 常層に対し侵れた引張強さや耐熱老化性など必要 性を付与し得た電力ケーズルの提供を目的として 為されたものである。

本葉明は、塩素化ポリエチレンに塩化ビニルを グラフト共重合させてなるグラフト共重合体とブ タジエンーアクリロニトリル共 重合体とエチ レン 共重合体をこれら3成分の混合比に関する三角座 襟(第1図)において点A(50%。20%。 30%, B(30%, 20%, 50%), H(20%, 30%, 50%), C(20%, 50%, 30%), D(30%, 50%, 20%), E (5 0 %, 3 0 %, 2 0 %)を各頂点とした六

た分子構造を有するものである。

次に本癸明の実施例について説明する。 外部半導電層はそれぞれ別表の各実施例。参考例 及び従来例に示された組成から構成され。ポリエ チレンI00重量部,ジクミルパーオキサイド 25 重量部及び 26 ーシーセーブチルフェノール 0.3 重量部から成る未架橋のポリエチレン絶縁体 と同時に I 3 5 Cの温度で導体 間上に押出される。 次に200℃で30分間加熱加圧されることに

よりポリエチレン絶縁体は架構され。有機過酸物 を含む外部半導電層にあっては何時にとれも架橋 化される。なお、別要中グラフト共重合体、ブタ ジェンーアクリロニトリル共重合体,エチレンー 酢酸ピニル共竄合体及びエチレンーエチルアクリ レート共進合体の配合単位はペースレジン中に占 めるそれぞれの重量%であり、これら成分以外の 各成分の配合単位は100度量部に対する重量部

又、アクリロニトリル量、酢酸ビニル量及びエチ ルアクリレート量はそれぞれ世量%であり。更に 特房 昭53-93390(2).

角形の 枠内に入るような割合にて混合せしめた混合物 (1988) 1 0.0 重量部と、導電性カーボンプラック 1 0 ~90重量を主体とした混和物によりその外部 半導電層を構成したととを特徴とする電力ケー ブルである。

前配のオレフイン重合体(ポリオレフイン重合 体も含む)としては、たとえばポリエチレン。 エチレンープロピレン共重合体。エチレンープ ロピレンージェン共重合体、エチレン一酢酸ビ ニル共宜合体。エチレンーエチルアクリレート 共重合体等が使用され、外部導電層を構成する 一成分としてのエチレン共重合体としては、上 記オレフイン重合体で例示されたエチレン共重 合体類が使用される。

グラフト共国合体は、たとえば塩素化ポリエ チレンを塩化ビニルモノマーで影視また紅溶解 させ、水分散系において有機過酸化物やアソン 化合物等と触媒して反応させること等により移 られるもので、塩素化ポリエチレンを幹ポリマ ーとしてこれに塩化ビニルがグラフト共量合し

無のアルフアベットはベースレジンの 畏中ペースレジン構成成分の混合比を示す第1図 の三角座標中の各アルフアベットにそれぞれ相当 するものである。



上配の各実施例及びその特性を第1級と第3級

外部半導電層のペースレジンを構成する各成分 はそれぞれ次のような機能を発揮し、それによつ て本発明の目的が達成されている。

即ち、グラフト共国合体は絶縁体と半導電層間の はく離性を確保し。同時に半導電層に対して充分 な引張強さを付与し、はく離作業時における当該 半導電腦の切断を助止するために重要な成分 であ り、又ブタジエンーアクリロニトリル共重合体は 絶縁体と半導電層間のはく離性を確保し、同時に 半導電腦に対して良好な停び特性を付与すること により外部半導電層はく離時の 座屈強度を高める ことになり、更には加工性を良好に維持する存在 となる。

しかし、混合比が50%以上になると耐熱老化性 が著しく悪化して、IP規格に規定された耐熱老

l,

老化性に不合格となる。

エチレン共直合体は外部半導電層と艶録体との 適度な接着性を確保する意味で必要な成分であり。 更には耐熱老化性を良好に維持する存在となる。

ごれら各成分にはそれぞれ与えられた機能を達成するために特定された配合量の制限が必要であり。その量はAEIC規格に規定されたはく離性度に基づいて設定される。同規格に定められたはく離強度は0.9~5.5%/1.25mm幅であり。これを満足するための各成分の配合量が第1図の三角座標に示されている。

即ち、朝1図においてグラフト共産合体が50%, ブタシエンーアクリロニトリル共産合体が20%及びエチレン共産合体が30%に相当する点A、同じく(30%, 20%, 50%)の点B、(20%, 30%, 50%)の点C、(30%, 50%, 20%)の点C、(30%, 50%, 20%)の点 D、(50%, 30%, 20%)の点 E を各 頂点とする六角形の枠内に在ることが必要である。グラフト共産合体が点C(又はB)に

達しない領域では外部半導電層のはく離が困難に なると共に引張強さが不充分なものとなり。逆に 点 A も 又は E)を越える領域では過度のはく離性 から屈曲力あるいはヒートサイクル作用時に外部 半導電層がはく離してコロナ放電を招くようにな

プタシェンーアクリロニトリル共重合体が点A (又はB)に達しない場合には伸び特性の不足からはく膣時の座屈強度が不充分なものとなり。逆に点C(又はD)を越える領域になると耐熱老化性が不充分となる。

このはく健時の座屈強度ははく離作象が多くの場合半導電腦の熔部を一部はく離させ、これを完全 に折り返して引きはがすようにして行われることから、折り返し部にクラックが発生し易い問題があり、従つてこれを防止するためには高い座居 強度が必要となる。

又、引張強度もこれは前述したようにグラフト共 直合体の混合量によっても左右される特性である が、良好なはく離作業を行うためには重要な特性

であり、これが不充分な場合にははく離作業中に はく離片が切断し作業進行に若しい困難を来たす ようになる。

エチレン共重合体が点D(又はE)に建しない 領域では絶縁体との接着力が不足するようになる と、共に耐熱老化性が不十分となる。又、点Bを 越える領域になると絶縁体に対する接着力が大き くなるためはく雌が困難となる。

ペースレジンに対する導電性カーボンブラック の配合量も重要であり。その量は導電性カーボン ブラックの質によつて適量が加えられる。

導電性カーボンブラックの量はその質によつて 変化し、アセチレンブラックあるいは薄電性ファーネスブラックにおいては 4 0 度量部に満たない 場合には導電性が不足するようになり、逆に 9 0 度 電部を越えるときには溶験時の流動性が低下し て加工性が悪くなると共に仲び特性が不充分なも のとなる。また特殊な構造をもつ導電性カーボン であるケッチンブラックEC(ライオン・アクソ ー社製)では多くの場合。グラフト共産合体の幹 ポリマーとして適用される塩素化ポリエチレンの 塩素含有量は、25~45重量%程度であり、塩 化ビニルのグラフト結合量は30~80重量% である。

又、ブクジエンーアクリロニトリル共立合体のア クリロニトリル結合量は15~55重量多のもの が好ましい。

又。エチレン共 電合体としては主 K エチレンー酢酸ビニル共電合体が使用されるが。特に酢酸ビニル結合量が20~50重量%の範囲内にあるととが好ましく。その溶酸指数は0.5~400程度である。

各種エステル系可塑剤,エポキン化合物,植物油あるいは燐酸エステル系可塑剤,などの各種可塑剤を加えることは当然考えられ、更には金属石けん類,無硬酸鉛塩,有機金属化合物,エポキン化合物等の安定剤やステフリン酸,ラウリン酸等の剤あるいはフェノール化合物,アミン化合物,確負系化合物等の酸化防止剤などが必要に応じて外部半導毒層に加えられる。

ケーブル絶縁体は多くの場合。架橋されるが、 その場合外部半導電層は架橋化されても架橋化されなくとも良い。

そして架橋、非架橋の如何に拘わらず、上述した ペースレジン中 3 成分の混合割合及び導電性カーボンブラック質と量は艇めて重要な条件となる。

外部導電層の架橋化はたとえばシ・クミルバーオキサイド、25ービス(tープチルバーオキン)25ージメチルヘキシンー3、13ービス(tープチルパーオキイソプロビル)ペンゼン等の有機 過酸化物などを混入し、これを加熱することによって行なわれるが、その場合、エチレングリコールジメクアクリレート、トリメチロールプロパントリメクアクリレート等の多官館モノマーを添加して銀額効率を高めるようにしても良い。

避難体と外部半導電器の形成手段としては種々 考えられる。

絶録体と外部半導電層とを同時に押出しても良く, あるいは絶録体を一旦押出した後。外部導電 層を押出すようにしても良い。架橋化する必要の 特開昭53-93390(4)
のあるときにはたとえば上述のようにして、絶縁体と外部半導電層とを押出形成した姿に加熱果構工程が付加される。

次に特性の試験方法について説明する。

- (I) 体験抵抗率は外部導電性を構成するための混 和物からそれぞれ 1 mm 厚さの試験シートを調整 し、JIS-K-6723 により測定した。
 - 実施例 4 を除いては何れも 1 8 0 ℃の熱プレス 加熱 により 3 0 分間 架橋した。
- (2) 耐熱老化性は IP 規格(66-524) KI 1P 利格 により利定した。 即ち、上配(1)の試験シートから採取した試験片を121での老化試験機中に168時間入れて熱老化を行った後、試験片を取り出して、JIS-K-6301 KI 19引張試験を行った。その時の伸びの絶対値が100以上で合格とし
- (3) はく離盤度は絶録体上から125 m幅の外部 半導電層をはく離するのに要した力であり、 AEIC規格(5-71)に規定された方法。即 ちはく離片増都を固定し、はく離片をケーブル

軸線とが常に90°の角度を保つようにして 700m/分の速度にてはく難することにより 弾定した。

- (4) 引張強さは上記(3)のはく離過程におけるはく 離片切断の有無を扱示した。
- (5) 座屈強度は絶縁体から一部はく離した外部半導層を絶縁体と接着している末はく離の外部半導電上に180°折り返し。これを700mm/分の速度にてケーブル軸方向に引張ることによりはく離した場合の上配折り返し部にかけるクランク発生の有無を表示した。
- (6) グル分率は上記(1)の試験シートから採取した 試料を70℃のテトラヒドロフラン中に24時 間浸漉した袋の元の試料中樹脂分に対する不溶 分中樹脂分の監量%である。

前述した参考例,従来例及びその特性を第2会と . 第4袋K示す。

図面の簡単な説明

第1回は本発明のケーブルにおけるグラフト共 取合体、ブタジエンーアクリロニトリル共重合体 およびエチレン共置合体の混合比に関する三角座 概、第2回はこの種ケーブルの一例を示す断面図 である。

1 : 導体。 2 : 内部半導電層。 3 : 舱線体。 4 : 外部半導電腦

代理人 弁理士 佐 藤 不二歳



	/	イクスメート	アラフト状気のは、 強化だった はをだより		100	19ル共派合体 ルモ	ひまどれ しょうかい		コケンン・ユチルノクリンート式画的店(ユチルブクリンート賞 20)	11 年 46 年 12 日 13 日 14 日 15 日	ステアリン酸色	86-ジーセーフテルフエノ ール	オリプロピレンアひペード	キャナッ 化大耳 音	8-EX(E-7540C-X404776EDA 2422)	7447	77-4	
			9	8	2	2	2	\$	ž.				Н		1	~	**	
5	-	•	3	•	30	•	,	32	-	20	6.5	S	1	•	-	2	-	
5		0	9	1	88	1	98	1	-		83	3	-	1	-	-	70	
5		m		20	.1	£	20	ı	•	-	80	83	-	si.	-	69	_	
8	4	1		30	,	80	-	0	î		ŝ	63	-	-	1	.09	١	
N. N.	8	3	38		-	35	,	9	-		90	3	30	-	-	-	90	
Ž	•	¥	_	30	83	ı		25	1	9	93	S	ı	١	-	ī	90	
ME	~	.3	-	32	9	-	38	1	ı	3	80	3	ı	1	-	88	-	
	-	=	1	0.	Ŀ	30	-		30	3	SO	3	ı	,	-	00		
MEN HOLD HELD SOLD SOLD SOLD SOLD THEN HELD SOLD SOLD SOLD	۵	4	30	-	ŀ	30	1	DR.	ı	3	8	3	ı	.1	-	22	-	E
K	2	•	9.0	-	2	1	ı	2	ı	n	8	3	,	ı	-	3	(通過
5	=		2	ı	2	,	1	9	1	,	3	3	1	1	-	1	\$	
SOUTH	~	۵	9,	ı	2	ı	ı	202	ı	,	80	8	ı	1	-	:	ī	
K BSK	21		80	ı	2	1	ī	2,0	,	,	s	3	ı	1	_	ī	ខ្ល	1
N. SE	Ξ	•	\$	ı	2	۱ ا	ŝ	ŀ	1	20	3	3	1	ı	-	3	t	1

		╗	116454	李子明 6 李光明 6 李明 6 李子列 6 李子列 10米角	# # 913	7144:4	##WS	914 62	19.49.7	¥.
Y 7 X I Y		-		م	•	•	-	•	0	•
メリント状態の谷(指統代ボジスケア	のり デルママス 10日		8.8	0.	=	=	ů	25	9	1
ン中の指数数 はおし	718	9		-	,	,	ŀ	ļ,	'.	١.
プラジエンーフタリロユトロル共間会	700007	•	-	1.5	3.0	9 8	,		:	1
#	1 W.	3.5	9 1	-	1	-	9.8	0.00	,	,
14ケーを取り15大馬の谷	前様ピュル書	9.0	,	٠,	ı	ı	ı		2	1
		1 48	3.0	8 8	8 8	0.6	1.5	5-		2
コチレンーエチルアクリレート共都会体(エチェアクリート数80)	1.79 U.L. 1. 12 1		1	,	,	١.	ı	 - 	'	'
13. 14. 14. 14. 14. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15		-			-	-	-	-	-	<u>'</u>
X 7 7 7 8 8		.	8.0	0.8	9 0	90	9.0	5	50	Ŀ
26-ジーセーブチフェノール				0.0		E 0	5	3		3
オリプロピンンアジベート			,	-	ı	-	٠	,	J.	١.
工业中文大耳音			-	-	,	,		<u> </u>		'
1.3 ーピスしょーブチルペーオキダイソプロピルシペンセン	プロピルトペン	¢	_	-	1	-	-	-	-	.
**************************************	74477		10	9	0.9	,	9.9	,	100	9
•	77-42	_		ı	,	0 9	,	:	•	Ŀ

£ -	120	配	1. 2.	科	松	3.5
双路列 以路内 双路的 取路的 11 18 13 14	101	司在	*101	草间	翠甸	8.8
# a	111	区内	31-46	五四	材	2
M M I	68	版	89-47-99-05	西	報	12
10	:	同·左	30-64	同在	围	9.2
# °	1 88	司在	10-48	西村	同在	:



15. 18.99	9	围	学 疆	1	-	09
Ē	- MIO	幸	1	五	₽ ₩	
	2	•	4	Œ	Œ	6
5	:	桌	90-40	125	₽2	
1	_	不合格	40	Œ	E	.=
₽ # #2 #	196	计令化	10~10	コマンなど	TURNE	7.9
16.074	116	不合格	1	8		1.

手 続 補 正 甞 (万式)

52.4.05

特許庁 長官 片山石 彫 股

事件の表示

昭和 52 年 特 許 顧第 7596 号

693の名称 16.7

補正をする者

事件との関係 特 許 出題人

4 \$6(512) 首**立電影**株式会社

代 理 人 〒100

居 所 東京都千代田区九ノ内 2 丁目 1 香 2 号 日立電線株式分社内 氏 名(7918) 分理士 佐 華 不 二 海 電路東京(216) 1 6 1 1 (大作表)

補正命令の日付

昭和 52 年 8 月 29 日

7 2 0

補正の対象 駅内の付の第1~第4 役 特正の内容 別紙の通り 挙付砂類の目録

(1) 第1~第4級

各1油

以上

B 1	. 茯
-----	-----

						源	1		袋		•	•	特別) #453— :	93390	M
			3586 (Pg)	关施约2	米面們3	发 物例	火m Pr 5	30%19 6	关贴例?	実施的8	突起例9	美胞例10	关肋例11	∮369 ¶12	KEM18	火瓶的1
~ - x	レジン		P	.0	Н	1	J	к	L.	М	Α	В	С	D	E	0
プラフト共直台体 塩素化ポリエチレン	塩化ビニル	40	45	40	-		85		_		50	80	20	80	50	40
の塩素量 85)	グラフト量	60	-	-	20	80	-	80	25	40		-	-	-		-
リタンエンーソクリロ	<i>7クリロニ</i> トリ	20	80	25 .	_	. –	-	45	40	_	_	20	50	50	80	25
ナリル共和合体	ル世	85	- "	_	80	80	85		-	-80	20	-				-
チレン・何度ビニル	的酸ビニル物	80	_	85	50		-	_	85	-	_	-	-	-	-	85
建合体	研製ビニル重	45	25		-	40	80	. 25	-		80	50	80	20	20	-
エチレン-エチルア (エチルアクリレ	クリレート共直 一ト量 20)	台拝	-	-,-	-	-	-		-	80	-		-	-	-	-
三型毒色		飾	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	ä	8	8	8
ステア	シン 家	绐	0.5	0.5	Q.5	u.s	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
26 - ½ - t - 7	ブチルフエノ・	- N	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	8.0	0.8	0.8	6.0	8.0	0.8	0.8	0.8
ボリブロビレ	ンアジベー	ŀ	_	-	1	-	20	-	-	-		-				
エポキシ	化大豆	789	_	-	5		-	-	_	-	_	-	_	_		· ·
1.8~ビス(t <i>-プチル</i> ベンゼン)	ニオキンイソプロ	ĽΊν	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1 .	1	1	1
1年在 カーボンブラツ	7 + + 1	·ン・	. 60	-	65	6 U	-		65	60	70	60	-7	65	-	90
P毛は カーホンノブツ	77-1	F.7.	_	70	_	_	60	60	_	_			60	_	60	i. – ·

			参考例1	参考约2	多考例8	参考例4	参考的5	参写的6	参考的7	従来的
ベ ー ス レ ジ	·		a	ъ	a	e .	£	в	G	-
グラフト共宣合体 (塩素化ポリエチレン	塩化ビニルグラ	40	5 5	80	15	15	80	55	40	_
中の塩素量 35)	フト室	60	_	_	-	-	-	-	-	-
	アクリロニトリ	20	_	15	80	55	-	-	25	-
ブタジエン・アクリロニトリル共富合体	ル量	85	15	-	_	_	55	80	_	
	4.00.0	80	_	_	_	-	_	· _	85	
エチルー酢酸ビニル共富台体	昨酸ビニル量	45	80	55	55	80	15	15	_	100
エチレノーエチルアクリレート共重合体(エチル)	アクリレート童 20)		-	-	-	-	-			<u> </u>
三垣善性城	读 绐		2	8	8	8	8	8	. 8	
ステアリン	ar #A		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	_
2 6 - ジー t - ブチルフ	エノール		8.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
ポリプロピレンアジ	· ~ - +		_	-	-	-	_	_	-	_
エポキシ大	豆 他		_	-		-		_	-	-
1.8 - ビス(t‐ブチルル・オキンイソブロリ	ニル) ベンゼン	*****	ı	1	1	1	1	1	1	1
	アセチレン		70	60	60	_	65	-	100	60
事覧性カーポンプラック	ファーネス		_	_	_	60	_	60	_	1 -

	実施例1	突跑例2	: 実施例8	光阳例4	火施例5	突延到 6	突動例?	実施的8	実施例9	実施例 10	美施例11	実施例12	突施例18	XII699 14
件模抵抗率(<u>()}-cm</u>)	210	45	140	206	156	66	121	280	128	184	89	177	107	10以下
町 無 老 化 佳	合格	向左	的左	问左	芦左	門左	向左	阿左	阿左	向左	向左	阿左	卜左	同左
なく作法度(Ag/125m)	1.1~24	18~26	35~45	42~47	27~38	34~4.6	4.5~5.1	10~18	1.0~1.5	5.0~54	47~5.2	31~45	10~14	18~25
ਤੋਂ। 58 5a ਦੇ	典状なし	的症	向左	內左	阿左	阿左	阿左	向左	的左	向左	阿左	内左	附左	的左
斯 AE SA SE	異状なし	阿左	p) 左·	阿左	內左	向左	问左	向左	門 左	門左	神左	内左	芦左	种症
グル分率(多)	5 5	62	71	-	68	68	67	61	56	75	71	69	52	58

谷考例1 参考例8 参考例4 参考例5 谷考例 6 谷考例7 從来 夠 抗 峯 (()-cm) 19¹6 165 180 180 162 116 145 10以下 合格 阿左 内左 不合格 **小合格** 不合格 台格 阿左 0.7~1.0 5.5~6.5 版 (Ng/125m) 5.8~6.1 0.8~0.8 0.2~0.6 1.5~28 はくかせす ð 異状なし 沟 左 内左 切断 典状なし 沔 左 內左 クランク 発<u>生</u> 阿左 **-** , 座 異状なし 異状なし 阿左 阿左

76

78

64

68

80

78

军 (多)

48